

WÄRMELEITENDE DICHT/KLEBSTOFFE, VERGUSSMASSEN, SILIKONGELS, FETT- und WÄRMELEITPASTEN

als zuverlässigen, langlebigen Schutz elektrischer und elektronischer Baugruppen.

Allgemeine Produkteigenschaften:

dauerhafte dielektrische Isolierung,
Schutz gegen Umwelteinflüsse, resistent gegen Zersetzung durch Ozon und UV-Strahlung,
Stoß- und Vibrationsdämpfer über einen weiten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich,
Physikalische und elektrische Eigenschaften bleiben auch bei extrem schwankenden Betriebsbedingungen erhalten



Einkomponenten - Dicht/Klebstoffe - <i>Thermal Conductive Adhesive</i>		
Silikonelastomer	Produkteigenschaften	typische Anwendungsbereiche
DC® 4420 RTV	weiß fließfähig moderat wärmeleitfähig schnell klebfrei	für Spannungsquellenkomponenten, Tintenstrahldruckerköpfen Verbund von integrierten Schaltungen mit Kühlkörpern
DC® SE 4422 RTV	grau hoch viskos moderat wärmeleitfähig in kurzer Zeit klebfrei UL 94V-1 Einstufung	für Spannungsquellenkomponenten, Tintenstrahldruckerköpfen Verbund von integrierten Schaltungen mit Kühlkörpern Abdichten von Gasbrennern für Heißwasser
DC® SE 4486 CV RTV	weiß fließfähig schnell klebfrei gering ausdampfend von -50°C bis +200°C	Vergießen, Kleben von Spannungsquellenkomponenten, Tintenstrahldruckerköpfen; Verbund von integrierten Schaltungen mit Kühlkörpern -> moderate Wärmeleitfähigkeit
DC® 9184 CV RTV	weiß nicht fließfähig kurze Verarbeitungszeit rasche Hautbildung gering ausdampfend UL 94 V-O - Einstufung	Verbund von Substraten integrierter Schaltungen; Befestigung von Deckeln und Gehäusen - Anbringen an Kühlkörper
DC® 4402	grau fließfähig schnell heißvernetzend gering ausdampfend	Kleben, Vergießen wo es auf gute Wärmeübertragung ankommt. Einbetten von Messfühlern, Druckerköpfen und Hochleistungsbaulementen
DC® SE 4450	grau hoch wärmeleitfähig hitzevernetzend	für Spannungsquellenkomponenten, Tintenstrahldruckerköpfen; Verbund von integrierten Schaltungen von Verbundkörpern
DC® SE 4173	grau gering fließfähig schnell hitzevernetzend hoch wärmeleitfähig	Verbund von Substraten integrierter Schaltungen; Befestigung von Deckeln und Gehäusen Anbringen von Grundplatten an Kühlkörper

Einkomponenten - Dicht/Klebstoffe - *Thermal Conductive Adhesive*

Silikonelastomer	Produkteigenschaften	typische Anwendungsbereiche
DC® SE 4174	grau gering fließfähig schnell hitzevernetzend hoch wärmeleitfähig glasperlenhältig - 178 Mikron	Verbund von Substraten integrierter Schaltungen; Befestigung von Deckeln und Gehäusen Anbringen von Grundplatten an Kühlkörpern (Glaskörper zur Kontrolle der Klebstofflinie)
DC® Q1-1818	grau glasperlenhältig - 178 Mikron schnell hitzevernetzend haftet grundierungsfrei	Verbund von Kühlkörpern an elektronischen Geräten, Verkleben gedruckter Leiterplatten an Substrate
DC® 3-6752 1:1	grau grundierungsfrei schnell hitzevernetzend	Verbund von Substraten in Hybridschaltungen, Leistungshalbleiterkomponenten und -geräten an Kühlkörper sowie Klebeanwendungen wo Flexibilität und Wärmeleitfähigkeit erforderlich ist

Zweikomponenten - Dicht/Klebstoffe - *Thermal Conductive Adhesive*

Klebstoffe	Produkteigenschaften	typische Anwendungsbereiche
DC® SE4400	grau semi fließfähig lange Topfzeit selbstgrundierend schnell hitzevernetzend	Verkleben von Hybriden oder Mikroprozessoren an Kühlkörper
DC® 1-9226	grau semi fließfähig lange Topfzeit selbstgrundierend schnell hitzevernetzend	Verkleben von Hybriden oder Mikroprozessoren an Kühlkörper
DC® Q3-3600 1:1	grau hervorragend fließfähig schnell hitzevernetzend lange Topfzeit selbstgrundierend UL 94 V-1 Einstufung	Vergießen von Hochspannungstransformatoren und Hochspannungssensoren, Anbringen von Hybridsubstraten an Kühlkörper
DC® 3-6605 1:1	grau mittel viskos gut fließfähig hitzevernetzend	Verbund von Substraten integrierter Schaltungen; Befestigung von Deckeln und Gehäusen; Anbringen an Grundplatte und Kühlkörper
DC® 3-6751 1:1	grau niedriger Elastizitätsmodul gering viskos hitzevernetzend UL 94 V-O Einstufung	Kleben von Kühlkörpern an elektronische Geräte; Verkleben von gedruckten Leiterplatten an Substrate
DC® 3-6753	grau gering viskos niedriger Elastizitätsmodul hitzevernetzend glasperlenhältig -178 Mikron	Befestigen von Kühlkörpern an elektronischen Geräten; Verkleben von gedruckten Leiterplatten an Substrate (7 Mil - 178 Mikron Glasperlen zu Kontrolle der Klebstofflinie)

Zweikomponenten Verguss- und Einbettmassen -> *Conductive Encapsulant*

Vergussmassen	Produkteigenschaften	typische Anwendungsbereiche
DC® SE 4410	grau gering viskos hitzevernetzend mittel wärmeleitfähig von -45 bis 200 °C UL 94 V-O	für Spannungsquellenkomponenten, Tintenstrahl-druckerköpfe; Verbund von integrierten Schaltungen mit Kühlkörpern
DC® SE 4447CV	grau gering viskos exzellent wärmeleitfähig hoch temperaturstabil nieder temperaturbeständig gering ausdampfend von -45 bis 200 °C	Vernetzt am Anwendungsort, Füllen von Zwischenräumen zwischen hitzeerzeugenden elektronischen Bauteilen und dem Kühlkörpergehäuse nur mit Dosieranlagen verarbeitbar!
DC® SE 4448CV Elastomer	grau hoch viskos hervorragend wärmeleitfähig hitzevernetzend extrem niedrig ausgasend von -45 bis 200 °C	Vernetzt hervorragend vor Ort, füllen von Zwischenräumen bei hitzeerzeugenden elektronischen Bauteilen und dem Gehäuse oder Kühlkörper. -> flüchtige Bestandteile - D4-D10 0,03 Prozent Gewicht
DC® Q3-3600 1:1	grau hervorragend fließfähig schnell hitzevernetzend lange Topfzeit selbstgrundierend von -45 bis 200 °C UL 94 V-1 Einstufung	Ausgießen von Hochspannungstransformatoren und Hochspannungssensoren, Anbringen von Hybridsubstraten an Kühlkörper
DC® 3-6651	grau gering viskos gut wärmeleitfähig niedriger Eleastizitätsmodul von -45 bis 200 °C UL 94 V-O	Ausgießen, Einbetten von Spannungsquellen, Stromrichtern und ähnlichen elektronischen Körpern, wo Wärmeableitung notwendig ist
DC® 3-6652	grau thixotrop, reduziert fließfähig läuft nicht ab gut wärmeleitfähig niedriger Elastizitätsmodul von -45 bis 200 °C	Ausfüllen von Zwischenräumen wo ein weiches wärmeleitendes Material und gezieltes Auftragen auf Bauteile erforderlich ist -> kein Abfließen auf andere Objekte
DC® 3-6655	grau gering viskos weich hervorragend wärmeleitfähig von -45 bis 200 °C UL 94 V-O Einstufung	Ausgießen, Einbetten von Spannungsquellen, Stromrichtern und ähnlichen elektronischen Teilen, wo Wärmeableitung notwendig ist

Einkomponenten Compounds -> Fett- und Wärmeleitpasten - *nicht vernetzend*

Compounds	Produkteigenschaften	typische Anwendungsbereiche
DC® SC 102	weiß nicht fließfähig moderat wärmeleitfähig gering ausblutend hohtemperaturstabil bis 177°C	Füllen von Zwischenräumen zwischen elektronischen Wärmequellen und Kühlkörpern
DC® 340 Heath Sink Compound	weiß nicht fließfähig gering ausblutend hohtemperaturstabil bis 177°C	Thermale Kopplung von elektrischen oder elektronischen Geräten an Kühlkörper
DC® SE 4490CV	weiß hoch wärmeleitfähig hohtemperaturstabil wenig ausgasend gering ausblutend bis 177°C	Füllen von Zwischenräumen zwischen elektronischen Wärmequellen und Kühlkörpern (niedriger Gehalt flüchtiger Bestandteile, geringes Ausbluten und Ausgasen aufgrund der Wärmezyklen)
DC® TC 5021	grau geringer Wärmewiderstand hoch wärmeleitfähig bis 177°C	Thermale Schnittstelle für CPUs usw. ; Siebdruck, Schablonendruck oder Dosierung
DC® TC 5022 1kg-Tuben	grau geringer Wärmewiderstand hoch wärmeleitfähig bis 177°C	Thermale Schnittstelle für CPUs usw. ; Siebdruck, Schablonendruck oder Dosierung
DC® TC 5026 1kg-Tuben	grau hitzebeständig leicht ausdrückbar	Zur Verarbeitung von Schnittstellen wo eine hochwärmeleitfähige Paste notwendig ist wie: Flip-chip BGAs, Microprozessoren, Power Moduls, Digital Micromirrorgeräte...
DC® TC 5121 1kg-Tuben	grau gut wärmeleitfähig standfest zuverlässig	Zum Einsatz in Medium-Power-Electronics und industriellen Anwendungen wie Microprozessoren, Flip-chip BGAs, Chipsets, Memory-Moduls, Power-Chucks, LED, ...
DC® TC 5600 1kg-Tuben	grau hervorr. thermische leitfähig, extrem leistungsfähig außergewöhnlich zuverlässig	Zur Applikation/Anwendung -> Siebdruck, Schablonendruck oder Dispenser für Server CPUs, Desktop CPUs, Grafik-Prozessoren, Power Module, LED Assemblies,
DC® TC 5688 1kg-Tuben	grau extrem leistungsfähig außergewöhnlich zuverlässig	Einsetzbar zum kühlen eines ICs in einem Computer mit einem Intel-Prozessor oder in Multi chip packages, Microprozessoren, Power Moduls, LED Assamles ...

Zweikomponenten Gels - *Thermaly Conductive*

Gels	Produkteigenschaften	Typische Anwendungsbereiche
DC® SE 4440 LP	grau gering viskos heißvernetzend UL 94 V-O	Füllen oder Vergießen von Zwischenräumen elektronischer Wärmequellen und Kühlkörper
DC® SE 4445 CV	grau moderat viskos fließfähig heißvernetzend	Füllen oder Vergießen von Zwischenräumen elektronischer Wärmequellen und Kühlkörper; Niedriger Gehalt flüchtiger Bestandteile (D4-D10 0,09)
DC® SE 4446 CV	grau moderat viskos fließfähig heißvernetzend extrem wenig ausgasend	Füllen oder Vergießen von Zwischenräumen elektronischer Wärmequellen und Kühlkörper; niedriger Gehalt flüchtiger Bestandteile (D4-D10 0,09)